

平成29年度 第4回モータ・パワーエシ・水素エネルギー研究会 技術セミナー

次世代自動車支援センター埼玉では、県内の自動車産業に関わる企業の技術開発力強化を支援するため、最新の技術動向や業界の技術ニーズなどの情報共有の場として技術セミナーを開催しています。

最近のEV化への流れの中で、自動車に限らず、エネルギーマネジメントにおいて重要なユニットであるインバータやコンバータなどの主要デバイスとして、高性能なSiCやGaNの半導体素子が使用されるようになってきました。今回は、今後のパワー半導体への期待と、その高性能ゆえの新たな実装技術の開発動向や課題についてお話させていただきます。

『次世代パワーユニットへの期待と実装技術の動向』

講演1

「燃料電池車へのFull SiC適用事例の紹介と今後のワイドバンドギャップ半導体への期待」

(株)本田技術研究所 四輪R&Dセンター 主任研究員 板東真史氏

<概要> 燃料電池スタック(FC STK)を含む電動パワートレインの小型化に大きく貢献したSiC適用FC昇圧コンバータ(FC VCU)を紹介します。またSiCを含むワイドバンドギャップ半導体への今後の期待について適用事例を交えて説明します。

<プロフィール> 2000年(株)本田技術研究所に入社後、現在に至るまでHEV、PHEV、FCVのシステム開発及びE-DRIVE部品の開発に従事。現在はインバータ、コンバータなどのパワーエレクトロニクス関連の研究に注力。

講演2

「次世代パワー半導体使いこなしのための実装技術」

サンケン電気(株) プロセス技術統括部 谷澤秀和氏

<概要> 近年SiCパワー半導体は普及の兆しが見られています。しかし、低損失だからとSiパワー半導体との単純な置き換えではSiCのメリットを活かしきれない可能性があります。今回はSiCの特徴を活かすために必要な技術を紹介いたします。

<プロフィール> サンケン電気に入社後、パワー半導体のパッケージ設計に従事。2012年よりNEDOプロジェクトに参加し、SiC高温実装技術の研究に従事。現在は内閣府のSIP(戦略的イノベーション創造プログラム)に参加。

日時 2018年 2月 7日 (水)
13:30~15:30

場所 新都心ビジネス交流プラザ 4階会議室
埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2
(JR埼京線 北与野駅前)

参加費 自動車産業部会会員：無料
公社会員：1,000円
上記以外(一般)：2,000円

問合せ (公財)埼玉県産業振興公社 次世代自動車支援センター埼玉 新産業振興部 IoT・技術支援グループ (千田)
338-0001 さいたま市中央区上落合2-3-2 TEL 048-621-7051 FAX 048-857-3921
URL <http://www.saitama-j.or.jp/jidosha/>

申込先 ホームページからお申し込み願います。 <http://www.saitama-j.or.jp/jidosha/?p=7845>

